

1. Record Nr.	UNICAMPANIAVAN00244568
Titolo	3D Microelectronic Packaging : From Architectures to Applications / Yan Li, Deepak Goyal editors
Pubbl/distr/stampa	Singapore, : Springer, 2021
Edizione	[Second Edition]
Descrizione fisica	XVI, 477 p. : ill. ; 24 cm
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia